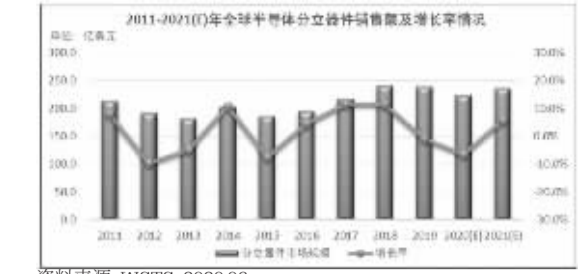


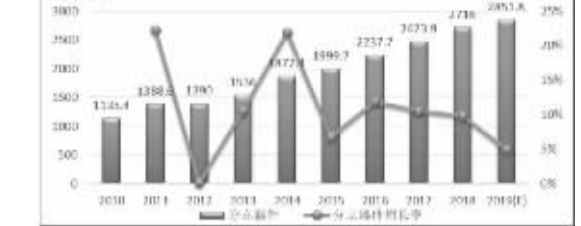
杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A109 版)



资料来源:WSTS,2020.06

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造,我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长,销售收入占全球比重逐年上升。



数据来源:中国半导体行业协会,2019.08

我国半导体分立器件行业起步较晚,主要通过国外引进及国内企业自主创新,逐步提升行业的国产化程度,满足日益增长的下游需求。

目前,国内半导体分立器件业务的市场竞争较为充分,半导体分立器件企业大致可分为三个梯队,具体构成情况及特征如下:

Table with 3 columns: 梯队 (梯队), 市场地位 (市场地位), 构成企业 (构成企业), 特征 (特征)

经过多年发展,公司已拥有完整的肖特基二极管芯片生产线,产品以中高端肖特基二极管芯片为主。

3.公司主要指标情况及2019年经营业绩变动原因

Table with 4 columns: 项目 (项目), 2019年度 (2019年度), 2018年度 (2018年度), 同比增幅 (同比增幅)

公司2019年度业绩下降的主要原因系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

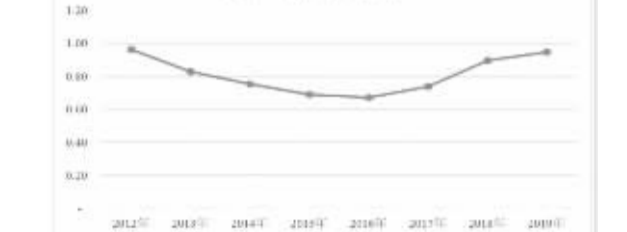
综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

变化。综上所述,发行人的外部经营环境及行业竞争地位未发生重大不利变化。

2.发行人的收入规模和综合毛利率水平对持续经营能力的影响分析

报告期内,发行人的营业收入分别为93,201.96万元、122,266.70万元和119,168.00万元。

2012年至2019年,全球半导体芯片市场价格波动情况如下图所示:



数据来源:SEMI

由上图可见,2017年起,全球半导体芯片市场明显回暖,产品需求持续上升,半导体芯片整体处于供不应求状态。

2019年下半年开始,全球半导体芯片市场景气度在达到阶段性高点后有所调整。

综上所述,预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生重大不利变化。

3.2019年业绩下滑主要因素对持续经营能力的影响

2019年公司经营业绩大幅下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期,包括8英寸及12英寸半导体芯片、第二代半导体射频芯片以及MOSFET芯片等多项产品正处于生产线建设或产能爬坡阶段。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

2019年,发行人研发费用较2018年增加2,995.81万元,财务费用率上升至7.55%。

综上所述,发行人2019年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

2019年,发行人研发费用较2018年增加1,038.01万元,研发费用率上升至8.14%。

法定代表人:王敏文

统一社会信用代码:91330100736871634P

互联网网址:www.li-on.com

2011年11月16日,立昂微电子领取了杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》

公司设立时,各发起人及其持股情况如下表:

Table with 5 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例), 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

本公司系由立昂有限整体变更设立,上述发起人均以立昂有限的净资产出资。

3.发行人有关股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为36,000万股,本次公开发行股票不超过4,058万股。

(二)持股数量及比例情况

1.自然人发起人

发行人整体变更设立股份公司时,共有47名自然人发起人,其中有33名自然人发起人目前仍为公司股东。

Table with 4 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

2.前十名股东

Table with 4 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

截至本招股意向书摘要签署日,发行人前十名股东持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

3.前十名自然人股东

Table with 4 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

截至本招股意向书摘要签署日,发行人前十名自然人股东持股数量及比例情况如下:

Table with 4 columns: 序号 (序号), 股东名称 (股东名称), 持股数量 (万股) (持股数量), 持股比例 (持股比例)

4.国有股份或外资股份

截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在国有股份或外资股份。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

Table with 4 columns: 股东A (股东A), 持股比例 (持股比例), 股东B (股东B), 持股比例 (持股比例)

四.发行人的业务情况

(一)发行人的主营业务

发行人的子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓主要从事半导体芯片业务

此外,发行人的子公司金瑞泓微电子主要从事12英寸半导体芯片业务

(二)发行人的主要产品及其用途

Table with 3 columns: 产品名称 (产品名称), 产品图片 (产品图片), 用途 (用途)

2.半导体分立器件芯片产品

Table with 3 columns: 产品名称 (产品名称), 产品图片 (产品图片), 用途 (用途)

3.半导体分立器件成品

Table with 3 columns: 产品名称 (产品名称), 产品图片 (产品图片), 用途 (用途)

(三)产品销售方式和渠道

公司生产的产品,主要通过代理商、经销商、直销等方式进行销售

(四)主要原材料及能源

发行人生产所需的主要原材料包括:多晶硅、石英坩埚、石墨件、切割磨片、抛光材料、外延材料、包装材料、金属颗粒、衬底片、硅外延片等

(五)全球市场竞争情况

1.全球市场竞争情况

从全球市场来看,半导体芯片市场具有较高的垄断性,少数主要厂商占据了绝大多数市场份额



数据来源:Gartner,2019.06

2.我国市场竞争情况

从我国市场来看,由于我国从20世纪90年代才逐步开始加大对半导体产业的投入力度

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家

截至2018年底,浙江金瑞泓具备月产12英寸硅片8英寸硅片的生产能力

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家

截至2018年底,浙江金瑞泓具备月产12英寸硅片8英寸硅片的生产能力

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家

截至2018年底,浙江金瑞泓具备月产12英寸硅片8英寸硅片的生产能力

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家

截至2018年底,浙江金瑞泓具备月产12英寸硅片8英寸硅片的生产能力

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家

截至2018年底,浙江金瑞泓具备月产12英寸硅片8英寸硅片的生产能力

根据IC Mtia统计,目前国内从事材料业务的公司主要包括浙江金瑞泓、研产中国、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中辰等十余家